

Doc.No : NR030709

2003年7月9日

安定した高生産性と高品質、短納期を追求した 新タイプの次世代塗布現像装置を発売

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区)の半導体機器カンパニー(社長：末武 隆成)は1時間あたり150枚を処理できる300mmウエハ対応の次世代塗布現像装置「RF³(アールエフキューブ)」を発売。2003年末までに一部ユーザーを対象に納入を開始するとともに、2004年1月から量産装置を出荷します。これにより、2005年度には塗布現像装置の市場において30%のシェア確保を目指します。

半導体デバイスのさらなる高集積化を目指し、回路パターンの加工線幅は次世代の90nm(ナノメートル=10億分の1m)、そして、その先の65nmへと微細化の一途をたどっており、それに伴い、回路パターンを焼き付ける露光装置の価格は一気に高騰しています。そのため、競争の激しいデバイスメーカーにとってフォトリソ工程の稼働率を高めることが重要な要素で、塗布現像装置には露光装置の生産力に最大限対応できる高信頼性と高生産性とCOO(コスト・オブ・オーナーシップ)*の低減が求められています。

今回発売するのは、そのような状況に応えるべく、「高信頼性、安定性の実現」=「Reliable」、「高生産性」=「Fast」、「微細化への対応」=「Fine」、「拡張性、短納期、短期立ち上げ」=「Flexible」という4つのキーワードをコンセプトに開発した塗布現像装置です。処理能力の向上を図るため、搬送ユニットへの負荷を低減し、信頼性を確保しつつ安定的に毎時150枚の高速処理を可能にしました。さらに、将来の露光機の生産性向上に対応するため、2年後には毎時180枚の処理性能を計画しています。また、塗布、現像、熱処理などの各処理部を用途別に独立ユニットとして設計し、全体の構造をシンプル化することで高信頼性を確保するとともに、短納期、短期立ち上げを実現。受注から納入までの期間は従来機に比べて大幅な短縮となる3カ月を予定しており、将来的にはさらなる短縮を見込んでいます。製品名は4コンセプトの頭文字から名付けたものです。

* 装置の導入から運用管理までにかかるトータルの費用

< 出荷開始予定 >

2004年1月

< 国内希望販売価格(消費税別) >

2億円~(仕様により異なる)

< 初年度販売台数 >

50台



RF³

☆この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。
(<http://www.screen.co.jp/press/photo.html>)

● 本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上ル4丁目